

# 設備の増強を推進

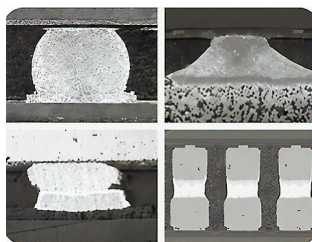
## 後工程技術の向上に注力

エスタカヤ電子工業(株)  
(岡山県早良町)は、半導

現社名に変更し、独立系O  
S A Tとして新たな道を歩

体後工程技術の向上および  
設備増強に取り組んでい  
る。幅広い顧客ニーズに対  
応できる技術力を磨き、事  
業の拡大を目指す。202  
6年度内をめどに、新規案  
件を順次量産化すること  
を目指す。

同社は、シャープグルー  
プの後工程協力会社だった  
が、20年に独立して21年に



様々なフリップチップエ  
法に対応

んでいる。シャープと合併  
で展開していたベトナムの  
カメラモジュール事業も25  
年に鴻海グループに譲渡  
し、現地法人を通じたエン  
지니어リングビジネスに転  
換した。

新規分野の開拓では、パワ  
ーデバイスの後工程受託に  
参入。電気自動車市場の減  
速などの逆風に見舞われな  
がらも、大手パワーバイ  
スメーカーから受注を獲得

し、量産を開始している。  
また、25年4月に技術開

発部を発足し、後工程技術  
のブラッシュアップを進め  
ている。チップレット実装  
などの2・x D / 3 D実装  
対応も視野に、既存の後工  
程技術の底上げ、対応可能  
なメニュー拡充を図ること  
で、他社が対応できずに困  
っている顧客からの受注獲  
得を狙う。

例えば、マイクロバンパ  
を用いたウェハーレベルC  
S P技術を確立した。また  
これに合わせて、バンパ付  
きウェハーのプロローテス  
ト、バンパの2 D / 3 D全  
数自動検査、バックグライ  
ンド、ダイシング、K G D

出荷も対応できるようにし  
た。一方で、ワイヤーバン  
プを使ったフリップチップ  
実装も対応可能で、バンパ  
数によってはめっき・はん  
だバンパに対しコストメリ  
ットが出る場合もあるた  
め、顧客がニーズにより選  
択できるようにする。早け  
れば26年内にサンプル供給  
予定だ。

F C B G Aも開発し、社  
内評価している。27年初頭  
には、フリップチップと他  
の部品を同時成形する一括  
M U Fモールドの量産化も  
計画している。そのほかに  
も長年培ってきたカメラモ  
ジュールは、小型から大型  
まで設計から製造まで一貫

で対応している。

技術開発と並行し、新規  
設備導入も進めている。25  
年には8 / 12インチウェハ  
ーに対応したバンパ後、高  
さの自動検査装置を導入。  
既存設備で実現しているチ  
ップの6面検査と合わせ、  
テストソリューションを拡  
充した。また、26年秋に真空  
ギ酸リフロー設備を導入。  
フラックスレスでボイドレ  
ス接合を実現可能だ。  
一部プロセスでは他社と  
も連携しつつ、ウェハーテ  
ストから個片化、組立、実  
装、最終検査まで一貫で請  
け負う体制を構築。顧客対  
応力を武器に、O S A T事  
業の拡大を図る。

